

Revision 2020_04_03

Lagenanzahl:

1-12

Impedanzkontrolle:

ab 4-lagig, inkl. bei Standardlagenaufbau.

Toleranz Impedanz:

±10%

Standardlagen-

aufbau 4-Layer:

(1,6mm Beispiel)

Top Layer (Layer 1)	35µm Kupfer
Prepeg 7628 oder 2313	200µm 7628 oder 100µ 2313
Inner Layer (Layer 2)	17,5µm Kupfer
Kern	1,065mm
Inner Layer 2 (Layer 3)	17,5µm Kupfer
Prepeg 7628 oder 2313	200µm 7628 oder 100µ 2313
Bottom Layer (Layer 4)	35µm Kupfer

Standardlagen-

Aufbau 6-Layer:

(1,6mm Beispiel)

Top Layer (Layer 1)	35µm Kupfer
Prepeg 2313	100µm
Inner Layer (Layer 2)	17,5µm Kupfer
Kern	0,565mm
Inner Layer 2 (Layer 3)	17,5µm Kupfer
Prepeg 2313	100µm
Inner Layer 3(Layer 4)	35µm Kupfer
Kern	0,565mm
Inner Layer 4 (Layer 5)	17,5µm Kupfer
Prepeg 2313	100µm
Outer Layer (Layer 6)	35µm Kupfer

Basismaterial:

FR-4 TG130-TG140, TG150-160 oder TG170-180 wechselnde
Hersteller nach Verfügbarkeit

Oberflächen:

Alukern, Rogers-Boards, HDI-Boards

HASL bleifrei, chemisch Gold (ENIG), Hartgold, chemisch Silber

ENEPIG und ohne Oberfläche (nur Kupfer)

Dimensionen max.:

500x600mm Für Multilayer: 500x550mm

Dimension min:

6x6mm

Kleinstes Nutzen:

100x120mm

Toleranz Dimension:

±0,2mm bei Konturfräsung und ±0,5mm bei Ritzung

Endstärken:

0,4mm-3,2mm

Toleranz Endstärke:

±10% ≥1,0mm oder ± 0,1mm <1,0mm

Farben Lötstopplack:

grün, rot, weiß, blau, schwarz, gelb

Farben Positionsdruck:

Standard, nicht veränderbar. Weiß oder schwarz

Endkupferstärke:

35µm - 455µm; Innenlagen bei Multilayer bis 210µm

Abhängig der Materialstärke.

Kleinste Leiterbahnbreite:

4mil; abhängig der Materialstärke.

Kleinster Leiterbahnabstand:

4mil (auch zu Via), abhängig der Materialstärke.

Kleinster Viadurchmesser:

0,2mm Loch und 0,4mm Pad

Bohrdurchmesser:

0,2mm-6mm

Bohrtoleranzen:

±0,08mm

Kleinster Restring:

≥6mil

Mindestabstand Leiterbahn Außenkante:

≥0,2mm, bei Ritzung ≥0,4mm

Abstand Leiterkarten im Fräsnutzen:

2mm

Mindest Nutzenrand:

4mm

Erweiterte Technologien:

Ja (Halblöcher, Via in Pad, Anphasen, metallisierte Kanten, Pressfit,
Carbon-Abdeckung, ablösbare Abdeckmaske, uvm.)

Die Herstellung der Leiterkarten erfolgt nach den Abnahmekriterien des IPC Standards IPC-600-A Klasse II.

Nach Klasse III auf Anfrage auch möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.